

No title available

Publication number: JP3021859U

Publication date: 1991-03-05

Inventor:

Applicant:

Classification:

- international: *H04N5/00; H01L27/14; H04B7/15; H04B7/26;
H04N5/335; H04N5/00; H01L27/14; H04B7/15;
H04B7/26; H04N5/335; (IPC1-7): H01L27/14;
H01L27/14; H04N5/335*

- European:

Application number: JP19890082588U 19890712

Priority number(s): JP19890082588U 19890712

Report a data error here

Abstract not available for JP3021859U

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

⑫ 公開実用新案公報(U)

平3-21859

⑤ Int. Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

⑬ 公開 平成3年(1991)3月5日

H 01 L 27/14
H 04 N 5/335

Z

8838-5C
8122-5F

H 01 L 27/14

D

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全2頁)

⑭ 考案の名称 固体撮像装置

⑮ 実 願 平1-82588

⑯ 出 願 平1(1989)7月12日

⑰ 考 案 者 矢 部 久 雄 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号 オリンパス光学工業株式会社内

⑰ 出 願 人 オリンパス光学工業株式会社 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号

⑱ 代 理 人 弁理士 伊 藤 進

⑲ 実用新案登録請求の範囲

表面に設けた光電変換回路手段及び裏面に設けた実装用手段を厚み方向に接続する接続手段を有する半導体基板と、

表面に半導体実装面、裏面又は側面側に入出力端子を備えた実装手段と、

からなり、前記実装手段の前記半導体実装面に、前記半導体基板の前記実装用手段をフェイスボンディングして実装したことを特徴とする固体撮像装置。

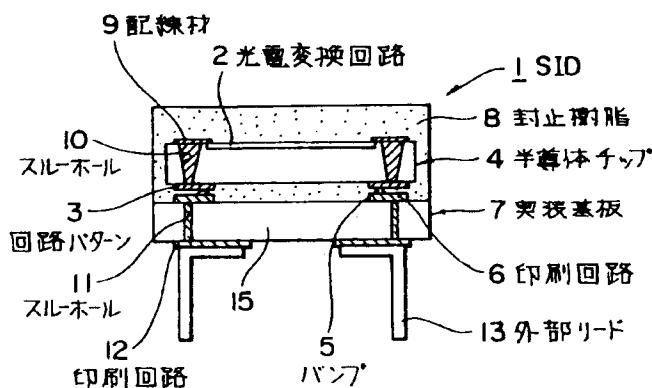
図面の簡単な説明

第1図ないし第7図は本考案の第1実施例に係り、第1図は第1実施例の固体撮像装置の構造を

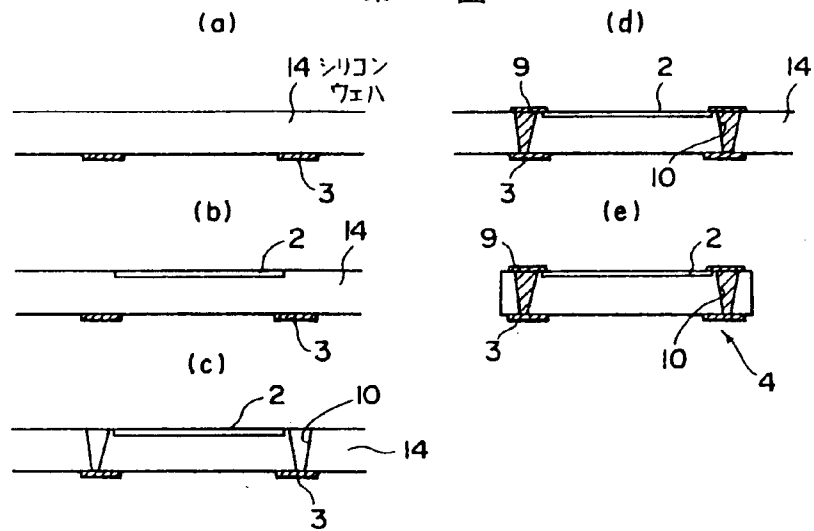
示す断面図、第2図は半導体チップの製造プロセスを示す説明図、第3図は半導体チップの平面図、第4図は半導体チップの底面図、第5図は実装基板の断面図、第6図は実装基板の平面図、第7図は実装基板の底面図、第8図は本考案の第2実施例の構造を示す断面図、第9図は本考案の第3実施例の構造を示す断面図である。

1……固体撮像装置、2……光電変換回路、3……回路パターン、4……半導体チップ、5……バンパ、6、12……印刷回路、7……実装基板、10、11……スルーホール、13……外部リード。

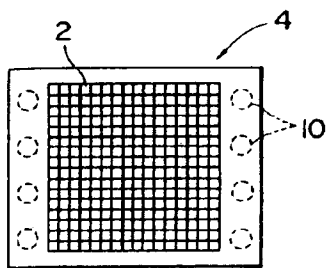
第1図



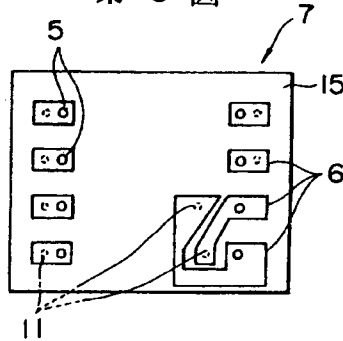
第2図



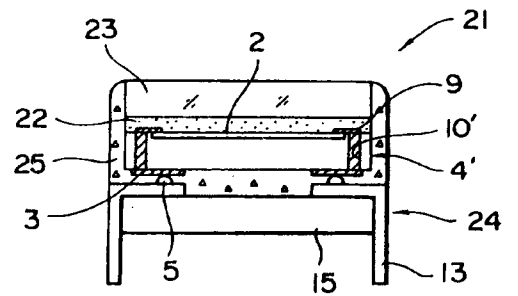
第3図



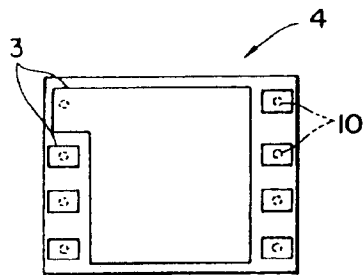
第6図



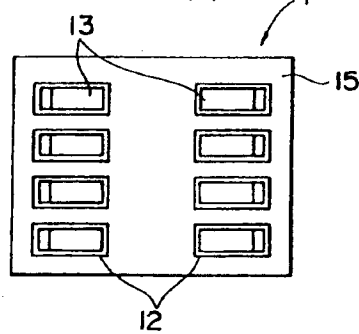
第8図



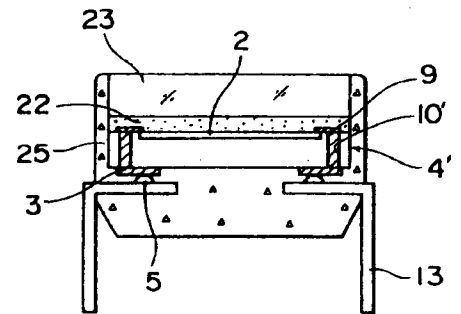
第4図



第7図



第9図



第5図

